

Benutzerdefinierter Ptfе-Wafer-Träger „Blumenkorb“ Chemikalienbeständig Halterung Für Halbleiterreinigung Design

Artikelnummer: PL-CP166



Einführung

Maximieren Sie die Halbleiterausbeute mit benutzerdefinierten PTFE-Wafer-Trägern und Blumenkörben. Entwickelt für überlegene Beständigkeit gegen Flusssäure und aggressive Reagenzien, verfügen diese hochreinen Handhabungssysteme über ergonomische Griffe und präzise CNC-gefräste Schlitze für eine sichere, kontaminationsfreie Nassprozessreinigung.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigungsprozesse	Sequentielle Reinigung unter Verwendung von SC-1- und SC-2-Lösungen zum Entfernen organischer Rückstände und metallischer Verunreinigungen.	Beständig gegen hohen pH-Wert und oxidativen Stress, ohne Verunreinigungen in das Bad auszuschwemmen.
Flusssäure-Ätzung	Entfernung von nativen Oxidschichten oder Opferglasschichten von Siliziumwafern unter Verwendung konzentrierter HF.	Vollständige Beständigkeit gegen HF, die sonst Glas auflösen oder Standardkunststoffe zersetzen würde.
Piranha-Ätzen / Strippen	Entfernung starker organischer Verunreinigungen oder Fotolack unter Verwendung einer Mischung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid.	Behält die strukturelle Integrität bei den hohen exothermen Temperaturen bei, die durch Piranha-Lösungen erzeugt werden.
Fotolithografie-Entwicklung	Eintauchen der Wafer in Entwicklerlösungen, um Schaltungsmuster nach UV-Belichtung zu definieren.	Präzises Schlitzens sorgt für eine gleichmäßige Belichtung der Waferoberfläche mit der Entwicklerflüssigkeit.
Spülen nach CMP	Hochreines Spülen nach chemisch-mechanischem Polieren (CMP), um Schlämpartikel zu entfernen.	Nicht haftende Oberfläche verhindert die Ansammlung von Schlamm und ermöglicht eine schnelle, vollständige Dekontamination.
Verbindungshalbleiter-Fab	Verarbeitung von GaAs-, InP- oder SiC-Wafern für Hochfrequenzelektronik und LED-Fertigung.	Schonende Handhabungsmerkmale verhindern das Brechen spröderer Verbundmaterialien.
Ultraschall- / Megasonic-Reinigung	Unterstützung der Wafer während der hochfrequenten akustischen Reinigung, um submikronische Partikel zu lösen.	Ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und chemische Stabilität unter akustischen Kavitationskräften.

Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP166	Anpassungsoptionen
Primäres Material	Hochreines Virgin PTFE (Polytetrafluorethylen)	Optional PFA für verbesserte Transparenz/Reinheit
Kompatible Wafer-Größe	4 Zoll (100 mm), 6 Zoll (150 mm), 8 Zoll (200 mm)	Benutzerdefinierte Durchmesser und nicht standardmäßige Formen verfügbar
Schlitzkonfiguration	Präzisionsgeschnittene V-Nuten- oder U-Nuten-Profile	Benutzerdefinierter Schlitzabstand, -tiefe und Winkelabstand
Kapazität	Standardkonfigurationen für 25 oder 50 Wafer	Maßgeschneiderte Batch-Größen von Einzelwafer bis Hochvolumen
Griff-Design	Integrierte obere oder seitliche Halterung	Abnehmbare, verlängerte oder automatisierungskompatible Griffe
Chemikalienbeständigkeit	Vollspektrum (Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Oxidationsmittel)	Verifiziert für HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH usw.
Betriebstemperatur	-200 °C bis +260 °C	Angepasst an spezifische Temperaturzyklusprofile

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP166	Anpassungsoptionen
Fertigungsmethode	End-to-End benutzerdefinierte CNC-Bearbeitung	Präzisionstoleranzkontrolle für automatisierte Schnittstelle
Reinigungsprotokoll	In Reinraum gewaschen und vakuumversiegelt	Spezialisierte Vorreinigung für Spurenanalyse